



# 145 活化抑制劑(Activate Inhibitor)

## §產品說明

現今電子工業上，印刷電路板（PCB）在製造時採用化學鎳、化學金流程已成為標準作業程式，但是在作業時，卻常常因為零件孔（NON-PTH 孔）的孔壁粗糙，造成除膠渣及鍍導通孔時，鈀膠體殘留，而使得零件孔沉積化學鎳、金層，產生一些困擾，為改正上述缺點，一般以鑽二次孔流程，可有效改善此缺失。

另一較佳選擇，則利用活化抑制劑 145 於剝錫鉛前使用，即可鈍化孔內殘留的鈀離子或鈀膠體，並降低孔內沉積化學鎳、金的發生。

## §操作條件

項 目 \ 條 件	標 準	範 圍
濃 度 145	15%	10~20%
溫 度	25°C	20 ~30°C
時 間	1min	0.5 - 2min

## §操作流程

剝膜——水洗——鹼性蝕刻——水洗——活化抑制劑 145——水洗——剝錫鉛——水洗——烘乾

## §維護與控制

- 1、每處理 1m<sup>2</sup> 補充 4-6ml/L，每升槽液約可處理 16-20m<sup>2</sup>
- 2、活化抑制劑，具微量臭味，使用時請戴口罩及手套，以避免臭味。
- 3、活化抑制劑，具特殊官能基，對廢水可直接混入處理。